

IPC-7711C/7721C
電子組立品のリワーク、改造およびリペア
CIS Certification Course Schedule



v1.1 July, 2018

1日目	Module	Task		Procedure	Skill Building	Workmanship
1	M1 (必須)	イントロダクション		—	—	—
2		プロフェッショナルトレーニングおよび認証方針と手順		—	—	—
3		一般情報および共通手順		1.1~1.9	—	—
4		※オープンブックテスト(25問)		—	—	—
5	M2	ワイヤースプライス	ラップスプライス	8.1.2	○	○
6			フックスプライス	8.1.3	○	○
7			重ねスプライス	8.1.4	○	○

2日目	Module	Task		Procedure	Skill Building	Workmanship	
1	M3	コーティングの除去	コーティングの識別	2.3.1	○	—	
2			コーティングの除去	2.3.3 or 2.3.4, 2.3.5	○	○	
3	M4	スルーホール部品	部品の取外し	3.1.1~3.1.4	○	○	
4			部品の取付け	J-STD-001 要件	○	○	
5							
6							
7							

3日目	Module	Task		Procedure	Skill Building	Workmanship
1	M5	チップ/円筒形部品	部品の取外し	3.3.1~3.3.3	○	○
2			パッドの準備	4.1.1, 4.1.3	○	○
			部品の取付け	5.3.1~5.3.2	○	○
3	M6	SOT/SOIC	SOTの取外し	3.5.1~3.5.2	○	○
4			SOICの取外し	3.6.2, 3.6.6	○	○
5		QFP	QFPの取外し	3.7.1, 3.7.1.1, 3.7.7	○	○
6		SOT/SOIC/QFP	パッドの準備	4.1.1~4.1.3	○	○
7			部品の取付け	5.5.1, 5.5.3~5.5.4	○	○
		D-PAK	部品取外し、パッド準備、取付け	追加要件	○	○

4日目	Module	Task		Procedure	Skill Building	Workmanship
1	M7	Jリード	部品の取外し	3.8.2 or 3.8.1.1 or 3.8.5	○	○
2			パッドの準備	4.1.1 or 4.1.2 or 4.1.3	○	○
			部品の取付け	5.6.1~5.6.4	○	○
3	M8	BGA	—	—	—	—
4	M9	基材のリペア	エポキシ工法	3.5.1	○	○
5	M10	導体のリペア	ジャンパー線	6.1	○	○
6			めっきホールのリペア	5.1	○	○
			表面実装パッドのリペア	4.7.1 or 4.7.2	○	○
7			導体のリペア	4.2.1 or 4.2.2	○	○

※内容は進捗状況により多少変更することがあります。